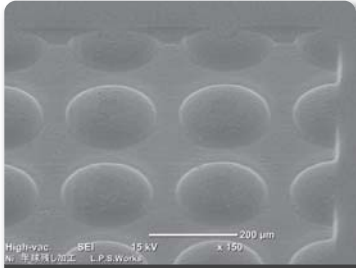
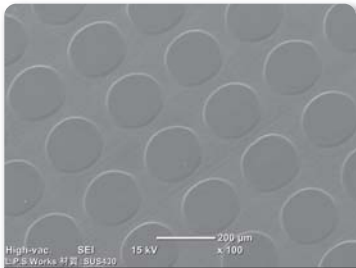


金属表面への レーザマイクロテクスチャー加工

微細エンボス加工

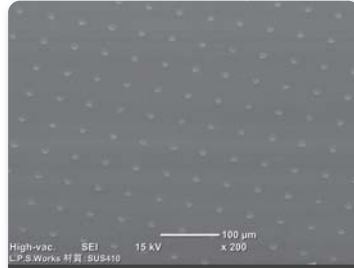


材質：Ni
穴径Φ200 μm・周辺深さ 30 μm

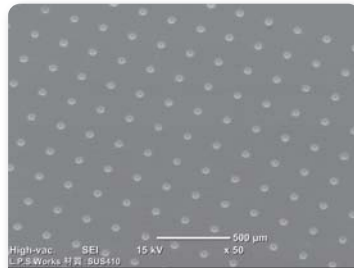


材質：SUS
穴径Φ190 μm・周辺深さ 4 μm

微細ディンプル加工

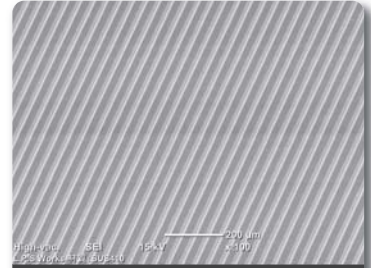


材質：SUS410
穴径Φ10 μm・穴深さ 1 μm

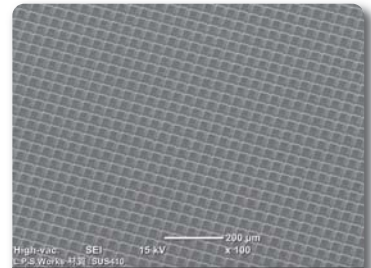


材質：SUS410
穴径Φ50 μm・穴深さ 5 μm

微細溝加工



材質：SUS410
溝幅 20 μm・溝深さ 2 μm



材質：SUS410
溝幅 20 μm・溝深さ 2 μm

加工の特徴

1. 超短パルスレーザーによる非熱加工の為、バリや溶融物が発生しません。
2. 形状、方向、深さ、加工パターン等の調整が可能です。
3. 高精度で規則的なパターンを選択的に付与する事が可能です。
4. 超硬、SKD材など高硬度材料に加工可能です。
5. レーザーディンプル加工を施すことにより低摩擦係数実現。

